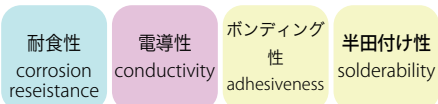


厚付け可能。半導体仕様のフォーナイン高純度金めっき



99.99%の純度。鮮やかなレモンイエローです。

99.99%の高純度でレモンイエローが析出します。

高純度のため、金の特性である**ボンディング性**にすぐれ、熱、圧力および超音波を与えることにより、金線やアルミニウムと接合できます。

また、皮膜特性を維持する添加剤により析出形態を改良しました。この結果、緻密な結晶を維持できるので**厚付けが可能**です。

さらに、半導体材料としてのコバルトおよび42アロイなどには、無光沢ニッケルを下地にすることで、**密着強度の高い、緻密な皮膜**が得られます。

■スペック

金 (Au)	99.99wt%
膜厚	0.1 μm~10.0 μm
硬度 (ヌープ)	50 ~ 80
電気抵抗	0.95 × 10 ⁻² (Ω/cm ²) (三菱ケミカル oresta-EPMCP-T360)
接触抵抗	0.3mΩ
半田付け	良好
ボンディング	良好
耐熱性	変退色なし (200℃ 24 時間)

純度: 99.99wt% の高純度のため、ボンディング性に優れます。

膜厚: 添加剤の種類によっては 300 ミクロンまでの厚付けが可能です。

電気抵抗: 金の特性により、優れます。

■応用例

ボンディングをしたい部品、厚付けにより耐食性を高めたい部品

- ・半導体: ワイヤボンディング・ダイボンディング・半導体パッケージ (ボンディング目的)
- ・デバイスケース: 変調器などの光通信機器用ケース (半田付け性・耐食性を高めたい)
- ・プリント基板: ワイヤボンディング (ボンディング目的)
- ・セラミックパッケージキャップ (熱加工による変色を避ける)
- ・レーザーミラー (熱による変色を避ける)



装飾分野にも応用できます。